

沪市汇

硬科硬客

## 科创成长层“成长记”

## 芯联集成赵奇：构筑三条增长曲线，预计2026年实现“有厚度盈利”

中经记者 孙汝祥 夏欣 北京报道

“感恩科创成长层，为‘硬科技’企业铺平创新发展之路。”芯联集成(688469.SH)董事长兼总经理赵奇日前做客《沪市汇·硬科硬客》第二季第7期节目“科创成长层‘成长记’”时表示，科创板支持未盈利企业上市，是资本市场一次重要的

## 科创板上市是公司发展“里程碑”

“过去的五六年是中国集成电路产业发展最生机蓬勃的阶段，标志性的起点就是科创板的推出。科创板包容、支持优质未盈利科技企业上市，起到了非常大的作用。”赵奇表示，科创板的制度创新推动了中国半导体产业从过去“单点突破”的发展模式，转向了全产业链的协同发展。

得益于科创板的包容性、适应性，2023年5月，尚未盈利的芯联集成成功登陆上交所科创板。

“对芯联集成而言，上市是一个里程碑。”赵奇表示。

首先，上市加速了公司的技术商业化。芯联集成通过上市募集资金约110亿元，这些资金支持企业持续投入研发创新和产能扩充，提升了企业的核心竞争力。公司的营业收入也从上市申报前一年即2021年的20多亿元，增长2倍多，达到2024年的65亿元。

第二，公司可以做到更长远的战略布局。据赵奇介绍，芯联集成已全面布局硅基功率器件、碳化硅、模拟IC这三大核心业务增长曲线。

第三，公司的企业品牌影响力明显提升。“这也有助于公司招募到优秀的人才，促进新技术、新平台、新应用研发合作的有效落地，为公司的持续创新打下更扎实的

制度突破，真正从科技创新“投入大、周期长、风险高”的规律出发，为“硬科技”企业发展提供了关键支持。

赵奇认为，在科创板上市，加速了芯联集成的技术商业化，公司营业收入从上市申报前一年即2021年的20多亿元，增至2024年的65亿元；同时，公司已全面布局

硅基功率器件、碳化硅、模拟IC三大核心业务增长曲线。此外，公司的品牌影响力也得到了明显提升。

随着公司产品结构持续优化，收入规模快速增长，AI辅助加精细化管理提质增效，设备折旧压力逐步缓解，赵奇对芯联集成在2026年实现扭亏为盈、成功“摘U”充满信心。



赵奇

芯联集成董事长兼总经理

基础。”赵奇称。

“作为一家科创成长层的半导体公司，持续的高强度研发投入是提升企业竞争力的关键。在科创板上市为我们提供了重要的资本赋能，给研发创新装上了‘加速器’。”赵奇表示，在上市前的2022年，公司的研发投入是8.4亿元；2025年前三季度，研发投入为14.9亿元，全年预计达到20亿元左右。

“受益于强研发投入，我们正在保持每1—2年进入一个新赛道，用3—4年的时间做到中国技术领先，6—7年的时间做到业界领先的产品开发及创新节奏。”赵奇称。

例如，芯联集成是4500V超高压IGBT(绝缘栅双极型晶体管)核心功率器件国内唯二的供应商之一，为国家新能源发电、水利重大工程等大基建项目的建设提供了

底层硬件支持。在碳化硅领域，芯联集成的SiC MOSFET产品累计新能源汽车装车量已经突破100万台。同时，公司投建了国内首条8英寸碳化硅产线，目前为国内首家实现批量量产的产线。

“对碳化硅技术的突破以及量产能力的建立，构筑了公司的第二条增长曲线。”赵奇表示，在碳化硅方面，公司2024年已实现10亿元营收，预计2025年营收将进一步增长到15亿元。

芯联集成的第三条增长曲线来自高压BCD(单片集成工艺技术)。赵奇称，公司最近一两年在高压BCD方面取得了突破，目前正在大量产品导入阶段。他预计，2025年实现营收3亿—4亿元，2026年应该突破10亿元。

## 对2026年扭亏为盈充满信心

作为科创成长层上市公司，芯联集成正稳步走在扭亏为盈的路上。

据赵奇介绍，2025年前三季度，公司营业收入创历史新高，达54.22亿元，同比增长约20%；归母净利润同比减亏2.21亿元，减亏幅度达到30%以上。

增收减亏的同时，芯联集成的经营还呈现出三大核心亮点。

一是模块收入持续成倍高增长，特别是在第三季度，单季增速达到2.5倍。

二是新能源业务保持快速增长的同时，AI正成为公司新的战略增长极。2025年上半年，公司8

英寸SiC MOSFET器件已经送样欧美AI公司，依托服务欧洲车企积累的客户资源与渠道优势，商业进程正在加速落地。“这标志着公司在‘新能源+AI’双赛道布局上取得了关键突破。”赵奇说。

三是公司盈利基本面持续夯实。公司前三季度毛利率约4%，较上年同期增加4.4个百分点，连续5个季度实现正毛利增长。

就2025全年而言，赵奇预计实现营业收入80亿元—83亿元，同比增长23%—28%。

对于扭亏转盈的“时间表”和“路线图”，赵奇预计2026年实现“有厚度的盈利”。

其信心来自四个方面：产品结构持续优化，SiC MOS、模拟IC等高价值量产品占比不断提升；收入规模快速增长，公司过去7年的年复合增速达到116%，预计2026年收入将超过百亿元，规模优势将不断凸显；AI辅助加精细化管理提质增效；随着公司8英寸晶圆生产线设备陆续出货周期，公司固定成本尤其折旧摊销部分逐步下降，这将促进盈利能力持续向好。

“有了上述四个方面的支撑，我们对在2026年实现扭亏为盈、成功‘摘U’充满信心。”赵奇肯定地说。

## 用足用好成长“工具箱”

为了支持科创板公司发展壮大，科创板提供了丰富的成长“工具箱”，包括明确再融资“轻资产、高研发投入”认定标准，支持并购优质未盈利企业等。同时，科创板大幅优化了股权激励制度，创设了第二类限制性股票激励工具。

芯联集成也是这些政策的受益者。

2025年9月，芯联集成收购芯联越州72.33%股权并完成交割，成为未盈利上市公司收购未盈利资产的标杆性案例。

通过收购，芯联集成将公司10万片/月与芯联越州7万片/月的8英寸硅基产能，整合成17万片/月的产能，通过集中管理和统一调配，实现更好的规模效应。不仅如此，赵奇还表示，上述并购“把公司第二增长曲线的碳化硅业务，从芯联越州上翻到芯联集成的体内来，芯联集成就可以用整个上市公司的资源和力量，进一步把碳化硅方向做大做强”。

股权激励也是芯联集成积极使用的工具。公司在上市次年即2024年推出了第二类限制性股票，授予核心骨干763人。

“当年公司实现营业收入65亿元，超额完成激励计划的业绩考核目标。”赵奇认为，这一成果充分体现了股权激励计划既起到了良好的激励作用，又实现了关键员工绑定，同时也最终促进了公司的稳健发展，达到了预期的效果。

对于政策创新，赵奇还有更多期待。

赵奇表示，希望优质未盈利企业上市后的再融资渠道能够得到拓宽，期待“先盈利再融资”的政策能有进一步调整空间。

此外，在并购重组方面，发行定向可转债购买资产是一个非常好的工具，但目前政策要求上市公司的盈利足以支付可转债一年的利息，所以亏损企业就无法使用这一工具。赵奇表示：“希望能

对科创成长层企业放开可转债的盈利要求。”

前瞻“十五五”，赵奇表示，“十五五”规划建议高频次强调科技创新，为科创板企业指明了发展方向。

作为一家集成电路制造行业的科创成长层企业，芯联集成将专注核心技术突破，在细分领域打造“隐形冠军”优势，致力于解决产业链“卡脖子”环节，同时通过终端应用做牵引，不断迭代技术构建“长板”竞争力。

同时善用金融资本赋能，保持高强度研发投入，有效转化融资为技术创新动能。积极融入国家创新体系，与产业链上下游协同发展，共同提升我国半导体产业整体竞争力。

“我们相信，科创成长层企业将成为科技创新体系中的重要活力源泉，在‘十五五’时期为实现高水平科技自立自强提供坚实支撑。”赵奇如是表示。

## 游玮：多领域“破卡强链”，埃夫特实现出“补课”到“领跑”跃升

中经实习记者 孙小琴  
记者 夏欣 北京报道

“科创板的设立与发展，是中国资本市场服务国家创新驱动发展战略的关键举措，助力产业在核心技术自主化方面取得突破。”埃夫特(688165.SH)董事长兼总经理游玮日前做客《沪市汇·硬科硬客》第二季第7期节目“科创成长层‘成长记’”时表示，埃夫特已经成为国内工业机器人的代表性企业之一，上市以来，公司实现了多个关键领域的“破卡强链”，也实现了诸多高端制造领域机器人的国产化。

## 科创板赋能催化成长

游玮认为，科创板的设立与发展，是资本市场服务国家创新驱动发展战略的关键举措，同时大大助力企业在核心技术自主化方面取得突破。

游玮表示，“硬科技”，特别是底层核心技术的创新，涉及我国产业链的安全。而涉及“卡脖子”技术领域的创新攻关，均具有周期长、投入大、风险高的特征，本质上是“难而正确”的战略性投入。

“这种创新模式往往使企业面临生存挑战，单纯依靠企业自有资金难以支撑长期持续的研发投入。”游玮表示，科创板通过构建稳定的融资通道，为创新企业提供了关键的研发资金支持。

结合埃夫特自身发展，游玮认为，科创板给“硬科技”企业赋能主要体现在三个方面。

第一，在科创板上市为企业持续创新提供了大量的资金支持，对技术研发、产品迭代、企业发展提

供了很大的帮助。

第二，企业上市后，能够快速提升市场影响力，形成品牌背书。以埃夫特为例，最为明显的变化是，客户结构从原来的中低端应用，逐步进入电子、光伏、汽车、锂电等多个行业，为公司拓展了服务更多行业龙头的机会。

第三，为公司持续创新奠定了人才基础。“硬科技”领域，人才是关键。上市之后，公司招募了大量高端人才。

为了支持科创板企业发展壮大，科创板提供了丰富的“成长工具箱”。

“科创板第二类限制性股票是个非常好的工具，对‘硬科技’企业非常重要。”游玮表示，公司高度重视科创板提供的制度红利，并持续关注再融资、并购重组等政策工具的最新动态。未来将审慎利用政策工具，助力公司持续发展。

## 技术研发从“补课”到“领跑”

在智能工业机器人领域，十几年前，90%以上市场份额被国外厂商垄断，其技术水平也远远领先中国公司。上市前，埃夫特的研发以模仿为主，上市后则转向自主创新。

“上市前，埃夫特是‘跟跑式’或‘补课式’研发。为了实现国产化，企业只能通过模仿、复制低难度的研发。”游玮介绍。

游玮表示，公司在科创板上市后，随着高端人才引进、新产业方向洞察、新一代人工智能技术迭代加速，为机器人技术融合提供了空间；随着国际技术进步

封锁导致创新难度提升，诸多领域无案例可模仿，开始在“无人区”探索。

“以机器人底层操作系统、专用操作系统及配套工具链的研发为例，这些领域均无参考对象，只能通过自主创新与市场需求驱动

实现突破。”游玮补充道。

在此背景下，埃夫特逐步实现从技术“补课”到“领跑”，进而向“并跑”和“领跑”的跨越，研发投入的持续增加转化为更具竞争力的创新成果。

经过十多年的发展，目前埃夫特已成为国内工业机器人的代表性企业之一，而且实现了很多关键领域的“破卡强链”，也实现了很多高端制造领域对进口机器人的替代。

游玮特别强调，在科创板上市之后，公司的研发得到全方位提升。

“上市前，机器人只能简单地搬运上下料，替代人工。上市后，公司补全了整个产品系列，未来会全面覆盖各个工艺场景。”游玮表示，机器人的应用也从搬运上下料，拓展至焊接、喷涂、打磨、抛光、去毛刺等有毒有害作业场景，推动传统制造业向智能化全面转



游玮

埃夫特董事长兼总经理

型升级。

此外，埃夫特在核心技术自主研发方面也取得了突破，解决了机器人的底层操作系统、运动控制内核、离线仿真软件及开发工具等一系列核心软硬件模块的自主化，实现机器人快速迭代。

与此同时，埃夫特在全球范

围内率先开展了工业机器人智能化研究，将机器人技术与人工智能技术进行结合，让机器人的智能化水平再上一个台阶，可以应对多品种、小批量的生产需求，可以自主规划、自主执行、自主完成，快速满足智能制造和转型升级的要求。

技术创新和突破。”游玮解释。

第二，在合规前提下，期待对于募集资金的使用赋予企业灵活调整空间。

“对于隶属于战略性新兴产业的公司而言，募集资金规划不确定性的特点是需要正视的。一般而言，公司从启动再融资计划、完成募投项目策划到审批完成，有2—3年的周期。其间，企业还面临着极快的技术迭代。”游玮进一步表示，如果按照原来规划的技术路径而不与时俱进的话，可能不利于企业的快速发展。

## 扭亏为盈依托规模增长和毛利率提升

突破核心技术之后，埃夫特的业务规模实现爆发性增长：上市初期机器人年销量约2000台，2024年突破16000台，市场占有显著增长。

“今年前三季度，埃夫特连续中标国内新能源头部车企订单超过1万台，首次实现国产机器人大规模进入汽车制造的各个环节。”游玮表示。与此同时，公司打造的智能机器人通用技术底座，获得国家科技重大专项的支持，为未来高质量发展奠定技术基础。

“上述两个变化促使埃夫特未来能够早日实现扭亏为盈。”游玮同时强调，盈利是企业形成核心竞争力的必然结果，埃夫特希望按预定的盈利路径，实现真正意义上的利润释放。

埃夫特扭亏为盈主要来自规模增长和毛利率的提升。

“规模增长主要来自两个方面：一是在存量的高端市场份额持续增长，高价值机型不断增加；二是依托智能化技术激发增量市场，这部分市场毛利高、价值量大，将成为支撑企业未来持续规模增长的动因。”游玮表示，随着

自主核心部件与自主核心模块的大规模使用，毛利率将得到持续提升。

针对企业面临“市场开拓与研发投入”双重压力的现实，游玮表示，希望科创板两项政策可以得到优化。

第一，希望再融资对未盈利企业开放，或者对未盈利但具备清晰战略目标的“硬科技”企业予以更多支持。

“企业上市的核心目标在于获得融资通道，并进行持续的技术投入。若因未盈利而导致融资通道受阻，将削弱企业持续进行